

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2007 年 11 月 1 日 (01.11.2007)

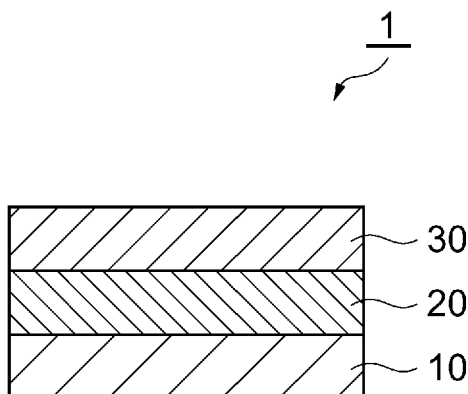
PCT

(10) 国際公開番号
WO 2007/123062 A1

- (51) 国際特許分類:
G03F 7/004 (2006.01) H05K 3/06 (2006.01)
G03F 7/11 (2006.01) H05K 3/18 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2007/058159
- (22) 国際出願日: 2007 年 4 月 13 日 (13.04.2007)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2006-114406 2006 年 4 月 18 日 (18.04.2006) JP
特願2006-231128 2006 年 8 月 28 日 (28.08.2006) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日立化成工業株式会社 (HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD.) [JP/JP]; 〒1630449 東京都新宿区西新宿 2 丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 斎藤 学 (SAITOU, Manabu) [JP/JP]; 〒3178555 茨城県日立市東町四丁目 1 3 番 1 号日立化成工業株式会社 山崎事業所内 Ibaraki (JP). 磯 純一 (ISO, Junichi) [JP/JP]; 〒3178555 茨城県日立市東町四丁目 1 3 番 1 号日立化成工業株式会社 山崎事業所内 Ibaraki (JP). 市川 立也 (ICHIKAWA, Tatsuya) [JP/JP]; 〒3178555 茨城県日立市東町四丁目 1 3 番 1 号日立化成工業株式会社 山崎事業所内 Ibaraki (JP). 大橋 武志 (HASHI, Takeshi) [JP/JP]; 〒3178555 茨城県日立市東町四丁目 1 3 番 1 号日立化成工業株式会社 山崎事業所内 Ibaraki (JP). 頼 華子 (YORI, Hanako) [JP/JP]; 〒3178555 茨城県日立市東町四丁目 1 3 番 1 号日立化成工業株式会社 電子材料研究所内 Ibaraki (JP). 宮坂 昌宏 (MIYASAKA, Masahiro) [JP/JP]; 〒3178555 茨城県日立市東町四丁目 1 3 番 1 号日立化成工業株式会社 電子材料研究所内 Ibaraki (JP).
- (74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外 (HASEGAWA, Yoshiki et al.); 〒1040061 東京都中央区銀座一丁目 10 番 6 号銀座ファーストビル 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: PHOTSENSITIVE ELEMENT, METHOD FOR FORMATION OF RESIST PATTERN, AND METHOD FOR PRODUCTION OF PRINT CIRCUIT BOARD

(54) 発明の名称: 感光性エレメント、レジストパターンの形成方法及びプリント配線板の製造方法



(57) Abstract: Disclosed is a photensitive element which comprises a substrate, a photosensitive layer and a protective film laminated in this order, wherein the photosensitive layer comprises a photosensitive resin composition comprising a binder polymer, a photopolymerizable compound, a photopolymerization initiator and a compound having a wavelength of maximum absorbance of 370 to 420 nm, and the protective film comprises polypropylene as the main ingredient.

(57) 要約: 支持体と、感光層と、保護フィルムとをこの順に積層してなり、感光層が、バインダポリマーと、光重合性化合物と、光重合開始剤と、極大吸収波長が 370 ~ 420 nm である化合物とを含有する感光性樹脂組成物からなり、保護フィルムがポリプロピレンを主成分とする、感光性エレメント。